

# 第84期 報告書

2018年4月1日から2019年3月31日まで



SHINKO

新光電気工業株式会社

証券コード6967





株主の皆様には、平素よりひとかたならぬご支援を賜り厚く御礼申し上げます。第84期報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶申し上げます。

代表取締役社長

藤田 正美

自動運転、EV（電気自動車）等の技術開発が加速する自動車や急速な拡大が想定されるIoT関連市場、また、人々の健康を支える医療分野など、半導体は、その頭脳として用途を広げ、今後も市場を拡大することが見込まれています。さらに、次世代移動通信規格（5G）の実用化等を背景とするビッグデータ、AIなどの広がりが、経済や社会の仕組みに変化をもたらし、これまでとは次元の異なるイノベーションを生み出す可能性を秘めており、半導体は、その可能性を実現するキーテクノロジーとして革新を続けていくことが期待されています。

当社グループは、半導体デバイスの優れた機能を人々の生活のなかへともたらずインターコネクトテクノロジーをベースに、高い競争力を持つ製品の開発・市場投入に努めてまいります。また、

お客様のニーズを的確に把握し、「品質・コスト・納期」を高次元で確立することにより、お客様にとって価値の高い製品・サービスをご提供することに努め、その成功を支え、信頼にお応えするとともに、それらの取り組みを通じて自らの発展・成長を目指してまいります。

さらに、当社グループの企業理念・指針である「SHINKO Way」の実践を通じ、持続的に企業価値を向上させ、社会の健全な発展に寄与するとともに、社会において必要とされる企業であり続けるべく、事業を展開してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2019年6月

### ■ 2018年度の事業概況

当期の半導体業界は、期前半は半導体需要の拡大等により、メモリー・自動車向けをはじめとして好調に推移しましたが、期後半以降、メモリーの供給過剰や米中貿易摩擦等を背景とした在庫調整の影響などにより、減速傾向が鮮明となりました。

このような環境の下、当社グループでは、半導体の微細化、高密度化に対応する次世代フリップチップタイプパッケージをはじめ、成長市場向けに重点的に経営資源を投下し、また、期後半にかけ総じて在庫調整の影響を受けるなど厳しい状況にあって、積極的な販売活動等を展開しました。これらの結果、セラミック静電チャックは半導体製造装置向けに売上が増加し、ヒートスプレッダーはサーバー向けの需要が拡大した一方、期後半にかけて、リードフレームやIC組立は在庫調整の影響を受け、また、フリップチップタイプパッケージは、期前半において受注が低調に推移したことなどにより減収となりました。これらにより、当期の連結売上高は1,422億77百万円（対前期比3.3%減）となりました。収益面については、経常利益は高付加価値製品の売上増加や為替差益の計上などにより76億49百万円（対前期比33.5%増）となりましたが、親会社株主に帰属する当期純利益は、リスク分担型企業年金を導入したことによる退職給付制度の移行に伴う損失ならびに固定資産の減損損失を特別損失に計上したことなどにより25億26百万円（同31.1%減）となりました。

単独決算につきましては、売上高1,360億3百万円（対前期比2.5%減）、経常利益85億84百万円（同57.0%増）、当期純利益35億72百万円（同2.0%増）を計上いたしました。なお、当期の配当につきましては、期末配当金を12円50銭とし、中間配当金の12円50銭とあわせて年間25円とさせていただきます。

### ■ 今後の見通し

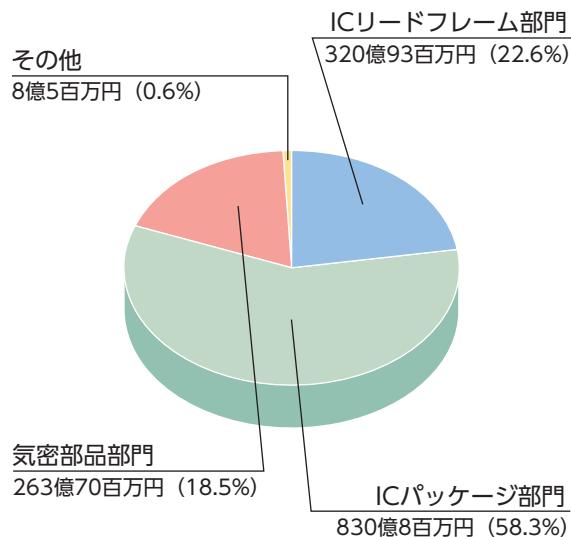
今後の半導体業界は、次世代移動通信規格（5G）の実用化等を背景として、今後、一層の活用の進展が見込まれるIoT・AI関連市場向けや、自動運転、EV（電気自動車）等の技術開発が加速する自動車向けなど、半導体需要はさらに拡大することが想定されます。一方、高度化する市場ニーズに対し、迅速かつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、世界規模での競争が一段と激化することが予想されます。

このような環境の下、当社グループは、サーバー用をはじめとする高性能半導体向けに、今後、需要拡大が見込まれる次世代フリップチップタイプパッケージについて、生産体制強化・増産のための設備投資を高丘工場（長野県中野市）等において展開するとともに、半導体メモリーの高速化・大容量化に対応する次世代プラスチックBGA基板や、中長期的な需要増加が想定される半導体製造装置向けのセラミック静電チャックの量産体制整備を推進するなど、高い成長が見込まれる市場向けに引き続き重点的に経営資源を投下し、市場の成長・拡大を当社の成長に結びつけるべく注力してまいります。加えて、これまで培ってまいりました多様な半導体実装技術をもとに、高い競争力を持つ製品の開発および生産体制構築に継続的に取り組み、「品質・コスト・納期」を高次元で確立することにより、事業基盤の一層の強化をはかってまいります。

当社グループは、引き続き成長が見込まれる半導体市場にあって、常にお客様のニーズを起点とし、お客様にとって価値の高い製品・サービスを提供することにより、「限りなき発展」を果たしてまいり所存であります。

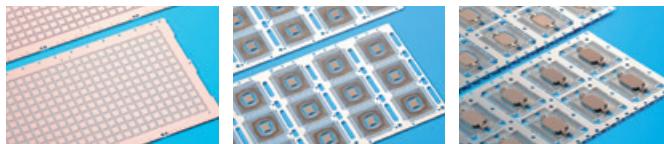
# 部門別の状況

## 部門別売上高構成



※ ( ) 内の数字は構成比率を表わしております。

## ICリードフレーム部門



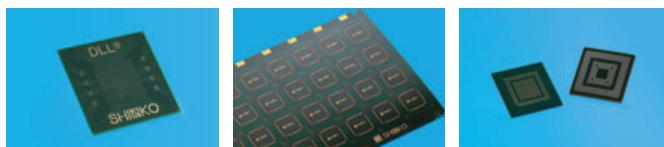
QFNタイプ  
リードフレーム

プレスリードフレーム

かしめリードフレーム

搭載製品例 スマートフォン、自動車、パソコン、家電・産業用他

## ICパッケージ部門



フリップチップタイプ  
パッケージ

プラスチック  
BGA基板

IC組立

搭載製品例 パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器他

## 気密部品部門



セラミック  
静電チャック

光学機器用ガラス端子

光通信用ガラス端子

搭載製品例 半導体製造装置、自動車、民生機器、通信機器他

売上高 **320億93百万円** (前期比 **↓8.4%**)

エッチングリードフレームは、需要変動の影響等により、期後半に入り売上が減少傾向となったものの、自動車やスマートフォンをはじめとして、幅広い用途向けに需要が増加し、増収となりました。一方、プレスリードフレームは、自動車向け等が在庫調整の影響を大きく受け、減収となりました。この結果、当部門の売上高は320億93百万円（対前期比8.4%減）となりました。

部門別売上高 (百万円)



売上高 **830億8百万円** (前期比 **↓2.3%**)

CPU向けヒートスプレッダーはサーバー向けに増収となりました。一方、プラスチックBGA基板は、スマートフォンのメモリー向け等の需要が減少し、IC組立はハイエンドスマートフォン向けに受注は増加したものの、自動車向けの在庫調整等により減収となりました。また、フリップチップタイプパッケージは、期後半以降、受注が回復傾向を示しましたが、期前半において売上が低水準で推移したことなどにより、減収となりました。この結果、当部門の売上高は830億8百万円（対前期比2.3%減）となりました。

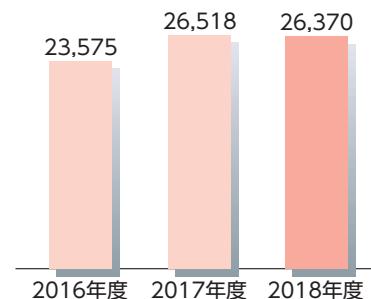
部門別売上高 (百万円)



売上高 **263億70百万円** (前期比 **↓0.6%**)

半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、メモリーの供給過剰等による設備投資抑制の影響を受けたものの、底堅い受注が継続したことなどにより、増収となりました。また、光素子用ガラス端子は、光学機器向けに需要が増加した一方で、光通信向けは低調なまま推移しました。この結果、当部門の売上高は263億70百万円（対前期比0.6%減）となりました。

部門別売上高 (百万円)



# 業績の推移

〔連結〕

## ■ 売上高



## ■ 経常利益 / 親会社株主に帰属する当期純利益



## ■ 総資産 / 純資産



## ■ 設備投資

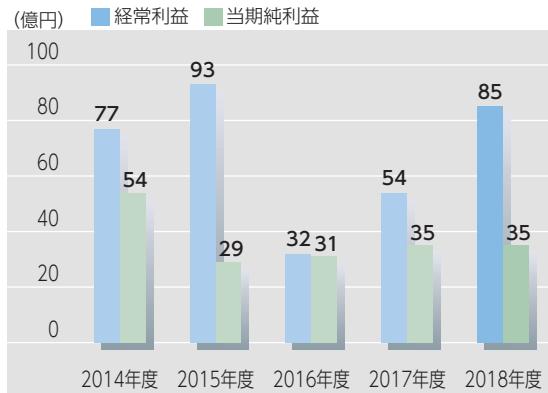


## 〔単独〕

## ■ 売上高



## ■ 経常利益／当期純利益



## ■ 営業成績および財産の状況の推移

区分	年度	2014年度 〔第80期〕	2015年度 〔第81期〕	2016年度 〔第82期〕	2017年度 〔第83期〕	2018年度 〔第84期 (当期)〕
〔連結〕						
売上高 (百万円)		142,815	143,453	139,890	147,113	142,277
経常利益 (百万円)		8,973	10,135	3,468	5,730	7,649
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)		6,442	3,476	3,007	3,664	2,526
1株当たり当期純利益		47円69銭	25円74銭	22円26銭	27円13銭	18円70銭
総資産 (百万円)		181,903	180,886	180,339	183,759	180,793
純資産 (百万円)		136,407	131,834	133,435	134,606	139,200
1株当たり純資産		1,009円75銭	975円90銭	987円75銭	996円42銭	1,030円43銭
設備投資 (百万円)		24,324	15,508	20,973	16,813	13,937
研究開発費 (百万円)		3,946	3,643	3,499	3,440	3,221

## 〔単独〕

売上高 (百万円)	133,898	134,960	132,504	139,464	136,003
経常利益 (百万円)	7,717	9,319	3,247	5,466	8,584
当期純利益 (百万円)	5,497	2,958	3,173	3,502	3,572

## ■ 連結貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：百万円)			(単位：百万円)		
科目	当期	前期	科目	当期	前期
資産の部	180,793	183,759	負債の部	41,592	49,152
流動資産	103,961	103,644	流動負債	36,477	36,947
固定資産	76,831	80,114	固定負債	5,115	12,205
有形固定資産	70,397	72,464	純資産の部	139,200	134,606
無形固定資産	1,234	1,237	株主資本	143,259	144,110
投資その他の資産	5,199	6,412	資本金	24,223	24,223
資産合計	180,793	183,759	資本剰余金	24,129	24,129
			利益剰余金	94,999	95,850
			自己株式	△ 92	△ 92
			その他の包括利益累計額	△ 4,058	△ 9,504
			負債純資産合計	180,793	183,759

## ■ 連結損益計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位：百万円)		
科目	当期	前期
売上高	142,277	147,113
売上原価	125,095	129,704
売上総利益	17,182	17,409
販売費及び一般管理費	12,334	12,510
営業利益	4,848	4,899
営業外収益	2,828	847
営業外費用	26	15
経常利益	7,649	5,730
特別損失	3,860	895
税金等調整前当期純利益	3,789	4,834
法人税、住民税及び事業税	1,851	1,395
法人税等調整額	△ 588	△ 225
親会社株主に帰属する当期純利益	2,526	3,664

## ■ 連結キャッシュ・フロー計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位：百万円)		
科目	当期	前期
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,456	21,806
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,105	△ 19,273
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,441	△ 3,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	739	△ 673
現金及び現金同等物の増減額	648	△ 1,581
現金及び現金同等物の期首残高	45,666	47,248
現金及び現金同等物の期末残高	46,315	45,666

## 次世代フリップチップタイプパッケージの生産能力を一層強化

フリップチップタイプパッケージは、半導体の微細化、高密度化に対応する半導体パッケージとして、大容量のデータを高速で処理するサーバー向けをはじめ、需要拡大が想定されています。当社は、これらのニーズをふまえ、次世代フリップチップタイプパッケージの生産体制強化をはかるべく、2018年度より高丘工場（長野県中野市）等において設備導入・生産ライン構築を行っています。

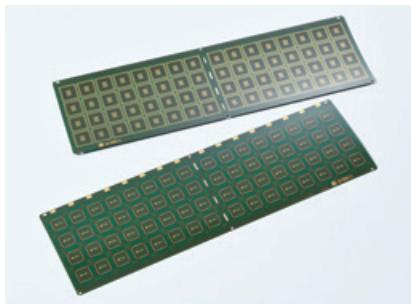
今後、IoT、AIの活用の進展や、次世代移動通信規格（5G）の実用化等を背景として、次世代フリップチップタイプパッケージは、高性能半導体向けにさらに需要を拡大することが見込まれます。当社におきましては、これらをふまえ、従来の計画を大幅に増額し、生産能力の一層の増強をはかるといたしました。

本計画により構築する生産ラインは、2020年度より順次稼働を開始する予定です。



高丘工場

## 次世代プラスチックBGA基板の製造ライン構築



プラスチックBGA基板

当社のプラスチックBGA基板は、高い信頼性が要求される自動車向け半導体やハイエンドスマートフォンなどに搭載される半導体メモリーに使用されています。今後、ハイエンドスマートフォンやタブレット端末、サーバーに搭載される半導体メモリーは、大容量化と高速化を目的として複数のメモリーチップを積み重ねる「多段積層」のニーズが一層高まり、半導体パッケージはさらに小型・薄型化をはかることが期待されています。

当社は、業界に先駆けて最先端のMSAP（Modified Semi Additive Process）工法による次世代プラスチックBGA基板の製造ラインを構築し、お客様のニーズに対応する半導体メモリー用パッケージをご提供することに注力してまいります。

# 会社の概要

## Corporate Data

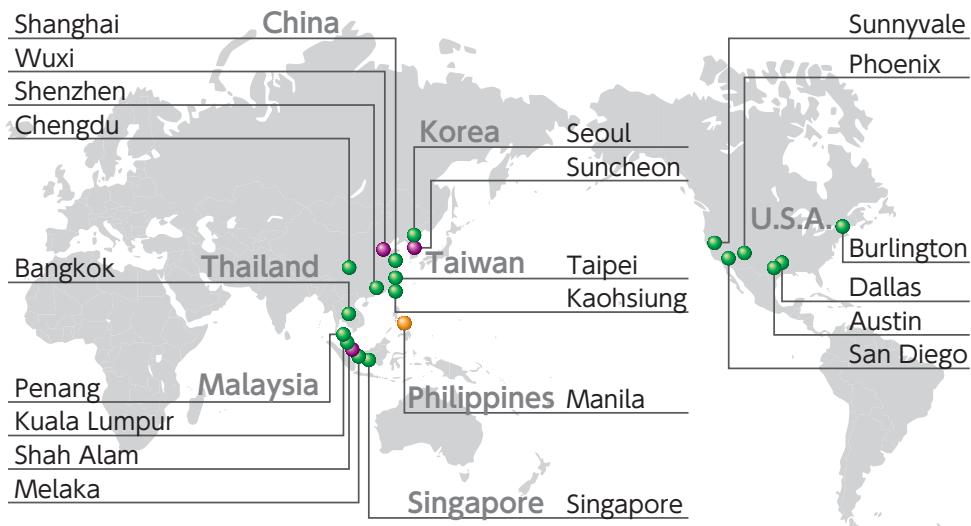
(2019年3月31日現在)

## 取締役

(2019年6月25日現在)

- 商号 新光電気工業株式会社
- 設立年月日 1946年9月12日
- 本社 長野県長野市小島田町80番地  
電話 (026) 283-1000 [代表]
- 主な事業内容 リードフレーム、プラスチック・ラミネート・パッケージ、ガラス端子などの製造・販売、ICアSEMBリ
- 従業員数 4,035名 (連結4,850名)
- 工場等 更北、若穂、高丘、新井、京ヶ瀬、  
新光開発センター、栗田総合センター
- 営業所等 東京、大阪、仙台、長野、名古屋、大分、福岡、  
マニラ
- グローバルネットワーク

代表取締役社長	藤田 正美
代表取締役専務執行役員	長谷部 浩
取締役常務執行役員	小平 正司
取締役常務執行役員	小澤 隆史
取締役常勤監査等委員	伊藤 明彦
取締役監査等委員	北澤 光二
取締役監査等委員	荒木 泉子



● 営業拠点 ● 駐在員事務所 ● 生産拠点

# 株式の状況

## Shareholders' Data

(2019年3月31日現在)

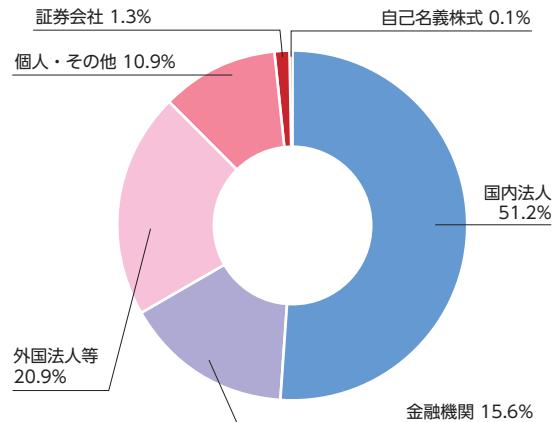
- 発行可能株式総数 540,000,000株
- 資本金 24,223,020,480円
- 発行済株式の総数 135,171,942株
- 株主数 15,683名
- 大株主

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
富士通株式会社	67,587	50.03
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	3,991	2.95
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	3,808	2.82
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	3,704	2.74
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	3,138	2.32
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	3,095	2.29
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	2,239	1.66
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HCR00	2,147	1.59
株式会社八十二銀行	1,836	1.36
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	1,828	1.35

(注) 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

## 所有者別株式分布状況

(2019年3月31日現在)



## 株主優待制度について

株主の皆様への日頃のご支援に感謝し、株主優待制度を導入しております。

### 対象となる株主様

当社株式を1年以上継続保有されているとともに、毎年3月31日を基準日として300株以上を保有されている株主の皆様

### 優待内容

当社工場が所在する長野県・新潟県の特産品 (3,000円相当)、社会貢献活動 (日本赤十字社) への寄付 (3,000円分) から選択

### 2019年3月期 株主優待のお申込みについて

対象となる株主様には、「株主優待のご案内」を別送させていただいております。お申込期限は**2019年7月31日(必着)**となっておりますので、まだ、お申込みされていない場合は、お早めにお申込みください。



写真は一例となっております。詳細は当社ウェブサイトでご案内しております。



## 株式事務のご案内

### ■株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

(連絡先) 三菱UFJ信託銀行株式会社  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
東京都府中市日鋼町1-1  
電話 0120-232-711 (通話料無料)

(郵送先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

### ■事業年度

4月1日から翌年3月31日まで

### ■基準日

定時株主総会関係  
配当金受領株主確定日

3月31日  
3月31日および中間配当金の支払いを行う  
ときは9月30日

### ■公告方法

電子公告  
当社は、公告を下記ウェブサイトに掲載して  
おります。

<https://www.shinko.co.jp/ir/kk/>

ただし、事故その他やむを得ない事由によっ  
て電子公告による公告をすることができない  
場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

### (ご注意)

1. 株主様の住所変更、配当金の振込みのご指定、買取請求その他の各種  
お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券  
会社等）にお問い合わせください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、  
三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記の連  
絡先にお問い合わせください。三菱UFJ信託銀行全国各支店におい  
てもお取り扱いいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払  
いいたします。



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町 80 番地  
電話(026)283-1000〔代表〕FAX(026)284-8861  
<https://www.shinko.co.jp>



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。



地球環境に配慮した植物油  
インキを使用しています